SURFACE TREATMENT OF GLASS SUBSTRATE

Publication number: JP2000203889 Publication date: 2000-07-25

Inventor: HIRAYAMA YOSHIO; KAWAGUCHI MASAO; MORISANE TOSHITOMO; TOKUSHIMA TADAO

Applicant: YUNIPPU KK

Classification: - International:

B08B3/08; C03C23/00; G11B5/84; G11B23/50; B08B3/08; C03C23/00; G11B5/84; G11B23/50; (IPC1-

7): C03C23/00; G11B5/84

- European: B08B3/08: G11B5/84B: G11B23/50D

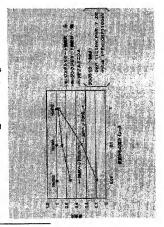
Application number: JP19990005296 19990112 Priority number(s): JP19990005296 19990112 Also published as:

US6461445 (B

Report a data error he

Abstract of .IP2000203889

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for surface treatment of glass substrate, modifying the surface of glass substrate so as to prevent the corrosion of glass substrate and to improve impact strength as final purposes. SOLUTION: A glass substrate after an abrasion process is treated with functional water having a plus oxidation-reduction potential(ORP) for a fixed time in the final cleaning process. The glass substrate after the abrasion treatment is cleaned with functional water having -50 to -300 mV ORP and then with functional water having +300 to +1,200 mV ORP in the final cleaning process. ORP and the treatment time are differed depending upon abrasion conditions. The hardness of the surface of glass substrate is increased, corrosion-resistant performances and orientation of stuck film are improved by the treatment.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-203889 (P2000-203889A)

(43)公開日 平成12年7月25日(2000.7.25)

(51) Int.Cl.7	徽別記号	FI	テーマコート*(参考)
C 0 3 C 23/00		C 0 3 C 23/00	A 4G059
G11B 5/84		G11B 5/84	A 5D112

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 13 頁)

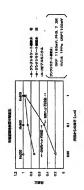
(21) 出願番号	特顯平11-5296	(71)出職人	598116288
			株式会社 ユニップ
(22) 出顧日	平成11年1月12日(1999.1.12)		東京都杉並区鉄線 5-1-15
		(72)発明者	平山 良夫
			静岡県駿東郡長泉町東野200-77
		(72)発明者	川口 正夫
			東京都杉並区获徽 5 - 1 - 15
		(72)発明者	森実 敏倫
			東京都練馬区羽沢 2-26-12
		(72)発明者	物島 忠夫
			神奈川県横浜市港北区太尾町2021-3 番地
		(74)代理人	100079201
			弁理士 石井 光正
			最終頁に続く
		1	

(54) 【発明の名称】 ガラス基板の表面処理方法

(57)【要約】

【課題】 ガラス基板の腐食の防止及び耐衝撃強度の向 上を最終的目的として、ガラス基板の表面を改賞するた めのガラス基板の表面処理方法を提供する。

【解決手段】 研磨工程を経た後のガラス基板を、最終 洗浄工程において、ORPプラスの機能水で所定時間処 理するようにした。研磨工程を経た後のガラス基板を、 最終洗浄工程において、ORP-50ないし~300m Vの機能水で洗浄処理した後、ORPプラス+300な いし+1200mVの機能水で処理するようにした。0 RP及び処理時間は、研磨条件により異なる。上記処理 により、ガラス基板表面の硬度が増し、耐食性能が向上 し、付着膜の配向性が向上する。



【請求項1】研磨工程を経たガラス基板を、最終洗浄工 程において、酸化還元電位がプラスの機能水で所要時間 **処理するととにより、ガラスの骨核を條復し、表面硬度** を向上させて、耐食性能を改善することを特徴とするガ ラス基板の表面処理方法.

1

「請求項2] 酸化還元館位が+300ないし+1200 mV. 処理時間が1ないし10分間であることを特徴と する請求項1に記載されたガラス基板の表面処理方法。 【請求項3】研磨工程を経たガラス基板を、最終洗浄工 10 程において、酸化還元電位が-50ないし-300mV の機能水で洗浄処理をした後、酸化還元電位が+300 ないし+800mVの機能水で1ないし2分間処理する ととを特徴とする磁気記録用ガラス基板の表面処理方

[請求項4]機能水は、酸素ガスをオゾン溶解膜を通じ て水中に溶解して又は水素ガスを水素溶解障を通じて水 中に溶解して作られたものであることを特徴とする請求 項1、2又は3に記載のガラス基板の表面処理方法。

【請求項5】機能水は、水の電気分解を利用して作られ 20 たものであることを特徴とする請求項1、2又は3に配 載のガラス基板の表面処理方法。

[発明の詳細な説明]

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、ガラス蒸板の表面 処理方法に関する。さらに詳しくは、コンピュータの記 録媒体として使用されるHDD(ハードディスクドライ バ)の磁気ディスク用ガラス基板又は液晶ディスプレイ 等に使用される電子部品実装用ガラス基板、とくに、化 学強化ガラス基板や結晶化ガラス基板の表面改質のため 30 の処理方法に関する。

[0002]

[従来の技術] 従来、磁気ディスク用基板として、表面 をNi-Pメッキしたアルミ合金基板が広く用いられて きたが、最近のHDDの高密度化に対応して、磁気ヘッ ドの低浮上化、耐衝撃性の向上のため、ガラス基板に対 する要求が増えてきている。

【0003】磁気ディスク用ガラス基板は、ディスクド ライパの回転による遠心力、磁気ヘッドとの衝突による 衝撃力に耐えるなどの特性が要求されることに伴い、通 40 せるためのガラス基板の表面処理方法を提供することを 常のガラスと異なる機械的強度、及び高密度記録再生に おいて十分なSN比を確保するための磁性膜の配向性が 要求される。

【0004】 ト記機械的強度を向上させるため、ガラス 基板として、所定の形状に加工した後、(a)ガラス成 分のNaをイオン半径の大きなKに置換し、表面に大き な圧縮広力を与えて確度を増した化学酶化ガラス、又は (b) ガラスマトリックス中に微細な結晶体を析出さ せ、その歪みにより強化させた結晶化ガラスが用いられ ている.

[0005]

[発明が解決しようとする課題] しかしながら、化学強 化ガラスは、アルカリイオン交換により確度を得るの で、ガラス表面にアルカリが多いため、研磨工程中に表 面がゲル化し易く、表面硬度も劣化し、真空中でその表 面に磁性膜をスパッタ中に水分の放出が多く、磁性膜の 配向性が下がるため、媒体のSN比が劣化する問題があ る。また、ゲルが空気中の水分や炭酸ガスと反応して、 腐食により磁気記録に影響を与える突起が生じる。これ を防止するため、硫酸や燐酸で基板表面を洗浄し、アル カリを除去することも提案されている(特期平9-22 525号公報)。この方法によれば、アルカリ成分は除 去されるが、ガラスの骨格を修復する酸化力が足りない ため、表面硬度の劣化が充分に回復せず、コロージョン が発生する。すなわち、研磨によりガラスの骨格である Si-O結合が研磨液に含まれているアルカリ成分によ り破壊されるため、表面の硬度は向上しないし、研算後 に表面に付着される磁性膜(付着膜)の結晶配向性も向 トしない。また、従来行われてきたガラス研磨後の除了 ルカリ洗浄は、これだけでは腐食防止に不十分であっ た。このため、脱アルカリ洗浄の後に、ガラス表面にア ルコキシド法によりシリコン酸化物をコートする方法も 行われてきたが、充分に反応させるためには、600℃ 以上の加熱が必要であり、これは、強化処理温度400 ~480℃を大幅に越すため、シリコン酸化物のガラス 化が不完全となる問題がある。

【0008】ガラスの研磨は、一般に、アルカリを含ま ない結晶化ガラスでも、通常、アルカリ研磨液でガラス の骨格であるSi-O結合を切断しながら研磨するケミ カル・メカニカル研修法 (CMP) により研修されるた め、表面の非晶質部分は強化ガラスと同様にゲル化し、 付着膜の配向性が乱れると同時に、表面が柔らかくな り、耐食性能及びヘッド衝撃強度が低下するという問題 がある。

[0007]本発明は、上記化学強化ガラスや結晶化ガ ラスを磁気記録用基板又は電子部品実装用基板として用 いるときに問題となるガラス基板の腐食の防止及び耐徳 撃強度の向上を最終的目的として、ガラス基板の表面を 改智し、その表面に付着される磁性膜の配向性を向上さ 課題とする。

[00008]

【議題を解決するための手段】従来、半導体の洗浄や液 晶ガラスの洗浄には、イオン水、ガス導入機能水が用い ちれてきたが、その大部分は、酸化還元電位(以下、○ RPという) がマイナスのアルカリ側で、付着粒子を除 去することが目的であった。磁気配縁用基板又は電子部 品実装用基板として必要な耐腐食性、硬度、結晶配向性 の改善の目的でテストが行われた報告はない。本発明者 50 らは、テストの結果、ORPの極性の違いと表面改質の 効果との間には、表1のような関係があることを見出し * (表1) た。

3

表面改黄の内容	有効なORFの極性
ごみ付着物の除去	有機物にはマイナス、金属にはプラスが有効
腐食防止	ブラス
硬度の向上	プラス
結晶配向性の向上	プラス

工程としてORPマイナスで除去できるごみ等を除去し た後、ORPプラスの作用を利用することにより、磁気 記録用基板又は電子部品実装用基板として優れた特性を 有するガラス基板を得ることができることを確認した。 【0010】上記課題を解決するため、本発明方法は、 研磨工程を経たガラス基板を、最終洗浄工程において、 酸酸化凝元電位がブラスの機能水で所要時間処理すると とにより、ガラスの骨格を修復し、表面硬度を向上させ て、耐食性能を改善することを特徴としている。研磨工 位がマイナス又はプラスの機能水で洗浄処理をした後、 上記酸酸化還元電位がブラスの機能水で処理すれば良 い。微粒子除去を必要としない場合もある。

[0011]酸化湿元電位は+300ないし+1200 mV. 処理時間は1ないし10分間であることが望まし い。この処理により、ガラス基板の表面の硬度が向上し て耐腐蝕性が向上し、付着膜の配向性が向上する。この 筋囲では、改管が増進される。

【0012】研磨工程を経たガラス基板を、最終洗浄工 程において、酸化潤元素位が-50ないし-300mV の機能水で洗浄処理をした後、酸化還元電位が+300 ないし+800mVの機能水で1ないし2分間処理する ことを特徴としている。洗浄処理において、有機物の微 粒子が除去されるので、ガラス表面が平滑になり、改管 処理における硬化、付着膜の配向性が一層向上する。 [0013]機能水は、酸素ガスをオゾン溶解膜を通じ

て水中に溶解して又は水素ガスを水素溶解臓を通じて水 中に溶解して作られたものを用いることができる。酸素 ガス又は水素ガスを導入した機能水は、電解イオン水と 同じ作用を行うが、電解イオン水よりも製造コストが安 40 く、経済的、工業的である。

[0014]機能水は、水の電気分解を利用して作られ たものを用いることもできる。コストは酸素ガス又は水 素ガス導入機能水よりも高いが、ORP、pHが同じな ち、作用は同じであるので、代用することができる。 [0015]

[発明の実施の形態]本発明によるガラス基板の表面処 理方法は、研磨工程を経た後の最終洗浄工程において、 概略、次の(イ)の洗浄工程と(ロ)の改質工程とを含 む。すなわち、まず、(イ)〇RPがマイナス又はプラ 50 【〇〇18】次に、本発明の実施例を説明する。

【0009】本発明は、上記事実に着目して、標準作業 10 スの機能水を用いてガラス基板を洗浄処理し、基板に付 着するどみ(微粒子)を除去する。ORPがマイナスの 機能水による洗浄により、ガラス表面に付着している有 機物の微粒子が除去される。ORPがプラスの機能水に よる洗浄により、主として金属系の微粒子が除去され る。通常、この洗浄の後、純水を用いて機能水を洗い流 す。ただし、研磨工程において微粒子の付着が見られな い場合は、(イ)の工程は不要である。すなわち、ガラ スは通常、水中では負に帯電して微粒子を電気的に吸着 しているが、どみと基板が閲覧位の場合は、反発してど 稈の後に、微粒子除去を必要する場合は、酸酸化還元電 20 みが剝がれ落ちる。有機物微粒子除去に用いられる機能 水のORPは、-300mV以上が有効範囲である。こ れ未満であると、アルカリ度が強く、ガラス骨格の破壊 が過大になるからである。好適な範囲は、ガラス基板の 研磨条件、すなわち、研磨剤の種類や研磨時間(浸漬時 間)等により異なる。図8は、研磨条件と表面相きの違 いを示す。同図は、pH6~4で浸漬時間1~3分間の 範囲が好適であること、pH3になると、表面が勢い粗 くなることを示す。次に、(ロ) ORPプラスの機能水 を用いて基板を処理して、ガラス表面よりアルカリ成 30 分、とくにNaを除去する。これと同時に、機能水の酵 化力によりゲル化したSi-O結合を回復させる。通 常、この後、純水を用いて洗浄し、乾燥する。これによ り、研磨工程において劣化した基板の表面硬度が修復さ れる。換言すると、研磨工程による基板の表面硬度の劣 化が治癒される。とのガラス表面の改賛のための処理に おいて用いられる機能水のORPは、+300ないし+ 1200mVが有効範囲である。好適な範囲は+300 ないし+600mVである。1200mVを越えると、 酸性が強く、ガラス表面が荒れてくるからである。好流 な範囲は、ガラス基板の研磨条件、すなわち、研磨剤の 種類や研磨時間等により異なる。図9は、研磨条件と表 面から100nmにおける硬さの違いを示す。 同図は、 SiO2 で研磨する場合は、機能水がpH5、1分間浸 漬が、また、Ceを用いる場合は、pH6、3分間浸渍 が好適であることを示す。機能水には、必要に応じて、 塩化アンモニウムなどの電解質を加えてp H調整、H* イオン量の調整をして、Na量の除去効率を増し、その 作用効果を向上させるととができることは、自明のとと である.

「実施例1]

*するイオン強化型強化ガラスである。 【表2】

(1) ガラス基板

本実施例で用いたガラス基板は、表2に示した成分を有*

5

用いたガラス基板:イオン強化型強化ガラス

ガラス基板の成分:SiO2 62. 0 wt% 3. 0 A 12 O3 B2 03 1.0 Na2O 9.0 K2 O 9.0 MgO 3. 0 ZnO 12.0 T i O2 0.6 A s 2 O 3 0. 2

S b 2 O 3

(2) 強化処理

上記イオン強化型強化ガラスを、次の条件の元で強化処 理した。

加熱濕度: 450°C 加熱時間: 6.5時間 融化深含: 50 um

(3) 最終研磨工程 強化処理を経た上記ガラス基板を、pH10のコロイダ ルシリカを研磨材として用いて、最終研磨工程を行っ

た,

(4)機能水を用いた処理(最終洗浄工程)及び効果 ※

※ O機能水処理による表面租度の改良

0. 2

最終研磨工程を経たガラス基板に対して、下記の表3に 示す各種条件の元で、機能水を用いた洗浄処理により付 着微粒子を除去し、減水で機能水を洗い流して、表面粗 度の改良を行った。機能水製造装置の電極室に加えた添 20 加剤は、ORP+側にはHcl、ORP-側にはNH。 OHを用いた。但し、pH6、ORP-400mVの場 合は、何も加えない。空気中のCO、ガス等によりpH 8になる。

ORP (mV)	рН	処理時間
- 370	9	137
+ 400	6	"
+ 560	5	"
+ 680	4	-
+ 830	3	,,
+1140	2	"
1	1	

[表3]

この表面程度の改良のための機能水処理の結果は、図1 に示すとおりである。表面粗度測定には、測定器「Ta ristep」(密標)を用いた。上記ORPの範囲の 度が5~7オングストロームと、極めて優良な値を示し ている。

②機能水処理によるアルカリ成分の除去

上記機能水処理による表面組度の改良工程に続き、OR P600mV pH4.5の機能水を用いて 1分間滑 清帆理し、挿水で洗浄した後、乾燥した。アルカリ成分 の測定には、表面分析器「ESCA」(アルバックファ イ社製)を用いた。図2にその測定結果を示す。図2に は、比較のため、機能水処理をしないガラス基板の側定 値も併せて示してある。図2から明らかなようは、処理 50 研磨工程によりガラスのゲル化が1μm程度であるとと

後のNa、Kの表面濃度が下がっている。 ②機能水処理による表面硬度の改善

F記機能水処理によるアルカリ成分除去工程と同時に、 いずれにおいても、処理なしの場合に比し、最大平均租 40 上配機能水を用い、同時間浸渍処理して、表面硬度の改 善を行った。図3は、機能水処理の有無と基板の表面か らの深さと硬度比との関係を示す。硬度比は、押込み法 により測定した。図3は、ガラス基板(ジンクシリケー ト) に機能水処理を行った場合の硬度を、同ガラス基析 に機能水処理を行なわない場合の硬度及びNi-Pアル 3合金基板の硬度と対比的に示している。 図3から分か るように、機能水処理により、研磨工程において生じた 硬度の劣化が修復されている。表面から1μm以上内部 では、ほぼパルク硬度となっており、本実験の場合は、

7 を示している。HDDにおけるトラック幅、浮上量の減 少に伴い、媒体の表面強度が一層重要になってきてい る。GMRヘッドに要求される衝撃強度に耐えるには、 最表面強度が重要である。この観点からも、機能水処理 が有効であることが判る。

の機能水処理による磁性膜の配向性の向 F.

上記の及び図の工程を経たガラス基板に対して、ORP 500mV.pH5の機能水を用いて、1分間浸渍処理 した。との処理により、強化処理及び研磨によりゲル化 より同復し、安定なSiO、に近付くため、付着膜の配 向性を示す $\Delta \theta$ 5 0 が小さくなり、結晶が揃う。すなわ ち、ガラスの骨格は、SiO。がゲル化すると、結合エ ネルギーが大きくなり、SiO、が結晶化すると、結合 エネルギーが小さくなって、安定なSiO。となる。図 4は、機能水処理によるガラス (ジンクシリケートガラ ス) の結合エネルギーの変化と $\Delta \theta 5$ 0 との関係を示す グラフである。図4(a)(b)(c)のそれぞれの縦 軸は光電子カウント数、横軸は結合エネルギーである。 同図(a)は強化処理なし、機能水処理なしの基板の例 20 を示し、K-Naイオン交換処理がないため、結合エネ ルギーの波が乱れない。(b) は強化処理あり、機能水 処理なしの例、(c)は強化処理ありで機能水処理をし た場合の例である。(b)は(a)よりも高エネルギー 側に、(c)は(b)よりも低エネルギー側にシフトし ていることが、認められる。すなわち、強化処理により 乱されたSi-O骨格が機能水処理により修復され、磁 性膜の配向性Δ θ 5 0 が小さくなり、結晶配向が明らか に向上される。

仍耐腐食件

通常の酸処理による基板(比較例1)と本発明の処理方 法によるガラス基板との放置際食テストの結果を、図5 及び図6の図面代用AFM (原子間力顕微鏡) 写真で示 す。 図5から、 通常処理では、製造後1ヶ月で腐食が見 られたが、本発明方法によるものは、図6に示すよう に、6ヶ月後も、腐食は見られなかった。なお、図5, 6のスケールはX(高さ)がそれぞれ20 um. 5 um である。図8では拡大しても腐食が見当たらないことを 意味している。

の水分放出量の測定

本発明方法により、ORPが+450mVの機能水を用 いて1分間処理したガラス基板と、従来の通常酸処理に よるガラス基板 (比較例2) とについて、真空中加熱 (真空度10-*Torr内で、温度上昇10℃/1分の

割合で赤外線加熱) による水分放出量を測定した。測定 練果を、関7に示す。なお、比較例2では、59,6℃ より59.9℃までの発生水量で、H, O分子量が1. 86×10¹¹個/cm¹ であったのに対し、本発明方法 によるものは、58、9°Cより601、2°Cまでの発生 水量で、H, O分子量が1.21×1016であった。と のように、本発明方法によるものの方が水分放出量が少 なかった。その理由は、脱アルカリ処理の結果は、いず れの基板も同じであると思われるが、本発明方法による したガラスの骨格Si-Oの結合状態が、水の酸化力に 10 ものは、ゲル化を修正する酸化力により、ガラス骨格が 補修されて、水分吸着力が低いからであると思われる。 [0017]

> 【発明の効果】上述のように、請求項1の本発明方法に よれば、ガラス基板の表面の硬度が向上するとともに、 その表面に付着される膜の配向性が向上する。従って、 磁気記録用基板又は電子部品実装用基板として必要なガ ラス基板の際食の防止及び耐衝撃強度の向上という最終 的目的が達成される。

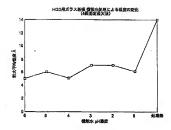
[0018] 請求項3の発明によれば、機能水による洗 漁処理により、ガラス基板表面の微粒子が除去されてガ ラス基板の表面の平滑性が向上するので、その後の機能 水による改質処理により硬化がさらに進行し、耐腐食 性 耐衝撃略度及び付着艦の配向性が一層向上する。 [0019]請求項4の発明によれば、電解イオン水よ りも安価で工業性に優れた媒質を用いて、基板表面の改 僧を行うととができる。

【図頭の簡単な説明】

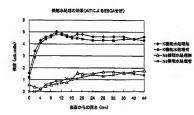
【図1】ガラス基板を機能水で処理した場合の表面組度 の変化を示すグラフ。

- 30 【図2】機能水処理の有無と表面硬度と表面からの深さ の関係を示すグラフ。
 - 「図3」名種基板の最表面の硬度比を示すグラフ。
 - [図4]機能水処理の有無とガラスの結合エネルギー変 化と $\Delta \theta$ 5 0 との関係を示すグラフ。
 - [図5]機能水処理をしないガラス基板(比較例1)の 腐食テストの結果を示すグラフ。
 - [図6] 本願発明方法を適用された基板の腐食テストの 結果を示すグラフ。 【図7】完成基板からの水分放出量テストの結果を示す
- 40 グラフ。 【図8】研磨条件の違いと表面処理による表面組さの違
 - いを示すグラフ、
 - [図9]研磨条件の違いと表面から100nmにおける 硬さの違いを示すグラフ。

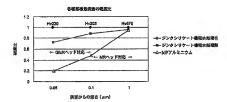
[図1]



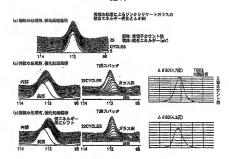
[図2]



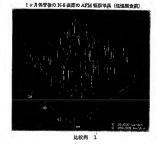
[図3]



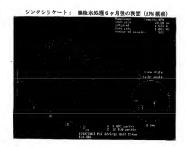
[図4]



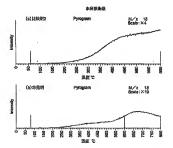
[図5]



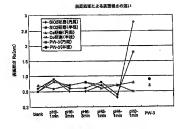
[図6]



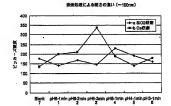
[図7]



[図8]



[図9]



[手続補正書]

[提出日] 平成11年3月19日(1999.3,1

9)

[手続補正1]

[補止対象書類名] 図面

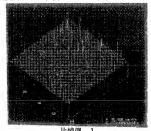
【補正対象項目名】図5

【補正方法】変更

【補正内容】 【図5】

図面代用写真(カラー)

1ヶ月保管後のN-5表面のAFM観察写真(促進腐食前)



比較例 1

【学続補正2】 【補正対象書類名】図面 [補正対象項目名] 図8

* 【補正方法】変更 [補正内容] * [図6]

図面代用写真 (カラー)





[手続補正書]

【提出日】平成11年12月9日(1999, 12.

8)

[手続補正1]

【補正対象書類名】明細書

[補正対象項目名] 0016

[補正方法] 変更

[梯下内容]

[0016]次に、本発明の実施例を鏡明する。

[実施例1]

(1) ガラス蒸仮

本実施例で用いたガラス基板は、表2に示した成分を有 するイオン強化型強化ガラスである。

【表2】

用いたガラス基板:イオン強化型強化ガラス

ガラス基板の成分:SiO2 62.0 wt% A 1 2 O 3 3. 0 B2 O3 1.0 Na2O g. n K2 O MgO 3.0 ZnO 12.0 T i O2 0.6 A 82 O3

As 2 O 3 0. 2 Sb 2 O 3 0. 2

[表3]

(2) 強化処理

上記イオン強化型酸化ガラスを、次の条件の元で強化処理した。

加熱温度: 450°C 加熱時間: 6.5時間 強化深さ: 50μm

(3) 最終研磨工程

磁化処理を経た上記ガラス基板を、pH10のコロイダ ルシリカを研磨材として用いて、最終研磨工程を行っ た。

(4)機能水を用いた処理(最終洗浄工程)及び効果 *

* ①機能水処理による表面租度の改良

級終研算工程を観光ガラス香板に対して、下部の表3化 示す各種条件の元で、機能水を用いた洗浄処理により付 着演性子を徐士し、純木で機能水を洗い硫化、表面短 度の改良を行った。機能水製造機関の電板盤に加えた影 加削は、ORP+側にはHell、ORP-側にはNH。 OHを用いた。但し、pH6、ORP-400mVの場 合は、何も加えない。空気中のCO、ガス等によりpH 6になる。

ORP (mV)	рН	処理時間
- 370	9	1.5}
+ 400	6	" ,
+ 560	5	~
+ 680	4	
+ 830	3	,,
+1140	2	"
1		i .

この表面租赁の改良のための機能水処理の結果は、図1 に示すとおりである。表面阻度測定は、測定器「Ta ristep」(商機)を用いた。上記ORPの範囲の いずれにおいても、処理なしの場合に比し、最大平均程 度が5~7オングストロームと、極めて復良な能を示し ている。

②機能水処理によるアルカリ成分の除去

上記機能水処理による表面粗度の吹曳工理化禁を、OR P800mV、pH4.5の機能水を用いて、1分間浸 透処理し、純水で洗浄した後、乾燥した。アルツリ成分 の測定には、表面分析器「ESCA」(アルバックファ イ社製)を用いた。図2化その測定結果を示す。図2化 は、比較のため、機能水処理をしないガラス諸安の制定 値も併せて示してある。図2から明らかなよう化、処理 後のNa、Kの表面濃度が下がっている。 上記機能水処理によるアルカリ成分除去工程と同時に、 上記機能水を用い、同時間浸渍処理して、表面硬度の改 養を行った。図3は、機能水処理の有無と基板の表面か らの深さと硬度比との関係を示す。 硬度比は、押込み法 により測定した。図3は、ガラス基板(ジンクシリケー ト) に機能水処理を行った場合の硬度を、同ガラス基板 に機能水処理を行なわない場合の硬度及びNi-Pアル ミ合金基板の硬度と対比的に示している。 図3から分か るように、機能水処理により、研磨工程において生じた 硬度の劣化が修復されている。表面から1 μ m以上内部 では、ほぼパルク硬度となっており、本実験の場合は、 研磨工程によりガラスのゲル化が1μm程度であること を示している。HDDにおけるトラック幅、浮上量の減 少に伴い、媒体の表面強度が一層重要になってきてい る。GMRヘッドに要求される衝撃強度に耐えるには、 最表面強度が重要である。この領点からも、機能水処理

が有効であることが判る。

②機能水処理による砂件職の配向性の向上

上記の及びのの工程を終たガラス基板に対して、ORP 500mV、pH5の機能水を用いて、1分間浸渍処理 した。との処理により、強化処理及び研磨によりゲル化 したガラスの骨格Si-Oの結合状態が、水の酸化力に より同復し、安定なSiO、に近付くため、付着膝の配 向性を示す $\Delta \theta$ 5 0 が小さくなり、結晶が揃う。すなわ ち、ガラスの世格は、SiO、がゲル化すると、結合エ ネルギーが大きくなり、SiO,が結晶化すると、結合 エネルギーが小さくなって、安定なSiO。となる。図 4は、機能水処理によるガラス (ジンクシリケートガラ ス) の結合エネルギーの変化とA 650との関係を示す グラフである。図4(a)(b)(c)のそれぞれの縦 軸は光電子カウント数、横軸は結合エネルギーである。 問図(a)は強化処理なし、機能水処理なしの基板の例 を示し、K-Naイオン交換処理がないため、結合エネ ルギーの波が乱れない。(b) は強化処理あり、機能水 処理なしの例、(c)は強化処理ありで機能水処理をし た場合の例である。(b)は(a)よりも高エネルギー 側に、(c)は(b)よりも低エネルギー側にシフトし ていることが、認められる。すなわち、強化処理により 乱されたSi-O骨格が機能水処理により修復され、磁 性膜の配向性Δ θ 5 0 が小さくなり、結晶配向が明らか に向上される.

6)耐腐食性

通常の酸処理による基板(比較例1)と本発明の処理方

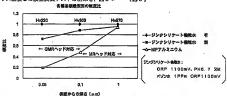
法によるガラス基板との放置腐食テストの結果を、図5 *

*及び図8の図面代用AFM (原子間力順微鏡) 写真で示 す。図5から、通常処理では、製造後1ヶ月で腐食が見 られたが、本発明方法によるものは、図8に示すよう に、6ヶ月後も、腐食は見られなかった。なお、図5、 6のスケールXは測定領域、Z軸は高さである。図6で は拡大しても摩金が見当たらないことを意味している。 の水分放出量の測定

本発明方法により、ORPが+450mVの機能水を用 いて1分間処理したガラス減板と、従来の通常酸処理に よるガラス基板(比較例2)とについて、真空中加熱

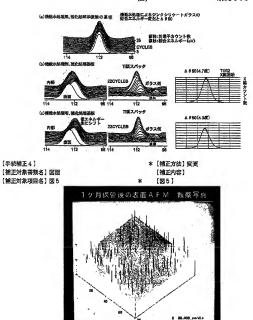
(真空度10-*Torr内で、温度上昇10°C/1分の 割合で赤外線加熱) による水分放出量を測定した。 測定 結果を、図7に示す。なお、比較例2では、59.8°C より59.9℃までの発生水量で、H。O分子量が1. 86×1016個/cm1 であったのに対し、本発明方法 によるものは、58,9°Cより601,2°Cまでの発生 水量で、H, O分子量が1, 21×1010であった。と のように、本発明方法によるものの方が水分放出量が少 なかった。その理由は、脱アルカリ処理の結果は いず れの基板も同じであると思われるが、本発明方法による ものは、ゲル化を修正する酸化力により、ガラス骨格が 補修されて、水分吸着力が低いからであると思われる。

【手続補正2】 [補下対象書類名] 関而 【補正対象項目名】図3 【補正方法】変更 [補正内容] [図3]



【手締補下3】 [補下対象書類名] 関而 【補正対象項目名】図4

[補正方法] 変更 [補正内容] [図4]



比較例

フロントページの続き

F ターム(参考) 4G059 AA08 AC18 5D112 AA02 AA24 BA03 GA08 GA28

(手続補正書)

【撮出日】平成13年3月19日(2001.3.1

9)【手続補正1】

[補正対象養領名] 明細書

【補正対象項目名】全文

[補正方法] 変更

【補正内容】

[書類名] 明細書

【発明の名称】 ガラス基板の表面処理方法

【特許請求の節囲】

【請求項1】 所定の形状に加工されたガラス基板を、 洗浄工程において、酸化還元電位がブラスの機能水で所 要時間処理することにより、ガラスの荷格を修復し、表 面硬度を向上させて、耐食性能を改善することを特徴と するガラス基板の表面処理方法。

【請求項2】 請求項1化記載のガラス基板の表面処理 方法において、前記載化選元報位がブラスの機能水は、 酸素ガスをオソン溶解膜を通じて水中に溶解して作られ たものであることを特徴とするガラス基板の表面処理方 法。

【請求項3】 請求項1又は2 化配載されたガラス基板 の表面処理方法において、酸化還元電位が+300ない レ+1200mV、処理時間が1ないし10分間である ととを特徴とするガラス基板の表面処理方法。

【請求項4】 所定の形状に加工されたガラス基板を、 洗浄工程において、次の(イ)(ロ)(ハ)の処理を行 うことを特徴とするガラス基板の表面処理方法。

(イ)酸化還元電位がマイナス又はブラスの機能水を用いてガラス基板を洗浄し、前配ガラス基板に付着する微粒子を除去する洗浄処理。

(ロ)酸化還元電位がブラスの機能水を用いて、ガラス 基板の表面からアルカリ成分を除去すると同時にガラス の骨格を修復する改質処理。

(ハ) 純水を用いて洗浄し、乾燥する処理。

【請求項5】 請求項4 に記載のガラス基板の表面処理 方法において、洗浄処理を繋化選元電位が-50 ないし -300mVの機能水で行い、改資処理を験化還元電位 が+300ないし+600mVの機能水で所定時間行う とと本特徴とするガラス表板の表面処理方法。

【韓邦項8 】 駅代選売電位がブラスの機能がは、酸素 ガスをオゾン溶解膜を選じて水中に溶解して作られたも のであり、駅化張売電位がマイナスの機能がは、水素ガ スを水素溶解療を選じて水中に溶解して作られたもので あることを特徴とする請求項4又は5に配載のガラス基 板の表面処理方法。

[請求項7] 酸化還元電位がマイナス又はプラスの機能水は、水の電気の解を利用して作られたものであると とを特徴とする請求項4又は5に配載のガラス基板の表 面処理方法。

「発明の詳細な説明」

【発明の評価な説明

[発明の属する技術分野1 本外明は、ガラス基板の表面 処理方法に関する。さらに伴しくは、コジェータの配 無線体として使用されるHDD(ハードディスクドライバ)の磁気ディスク用ガラス基板又は液晶ディスプレイ 等に使用される低于部品実施用ガラス基板、さくに、化 学験化ガラス基板や結晶化ガラス基板の表面改質のため の処理方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、磁気ディスク用基板として、表面 をNiーPメッキしたアルミ合金基板が広く用いられて きたが、最近のHDDの高密度化に対応して、磁気ヘッ ドの低浮上化、附衝撃性の向上のため、ガラス基板に対 する要求が増えてきている。

[0003] 磁気ディスク用ガラス基板は、ディスクドライバの回転による遠心力、磁気ヘッドとの衝突による 商弊力に耐えるなどの特性が要求されることに伴い、連 第のガラスと異なる機械的強度、及び高密度記録再生に おいて十分なSN比を確保するための磁性膜の配向性が 要求される。

[0004]上配機械的強度を向上させるため、ガラス 基板として所定の形状に加工した後 (a)ガラス成分 のNaをイオン半径の大きな比に置接し、表面に大きな 圧縮応力を与えて強度を増した化学徴化ガラス、又は (b)ガラスマトリックス中に管備な法晶体を折出さ

せ、その歪みにより強化させた結晶化ガラスが用いられている。

[0005]

[発明が解決しようとする課題] しかしながら、化学強 化ガラスは、アルカリイオン交換により強度を得るの で、ガラス表面にアルカリが多いため、研磨工程中に表 面がゲル化し易く、表面硬度も劣化し、真空中でその表 面に磁性膜をスパッタ中に水分の放出が多く、磁性膜の 配向性が下がるため、媒体のSN比が劣化する問題があ る。また、ゲルが空気中の水分や炭酸ガスと反応して、 腐合によりヘッドクラッシュ等の磁気記録に影響を与え る突起が生じる。これを防止するため、硫酸や燐酸で基 板表面を洗浄し、アルカリを除去することも提案されて いる (特開平9-22525号公報)。 この方法によれ ば、アルカリ成分は除去されるが、ガラスの骨格を修復 する酸化力が足りないため、表面硬度の劣化が充分に回 復せず、コロージョンが発生する。すなわち、研磨によ りガラス表面の骨格であるSi-O結合が研磨液等に含 まれているアルカリ成分により破壊されるため、表面の 硬度は向上しないし、腐食を生じるので、研算後に表面 に付着される磁性酸(付着膜)の結晶配向性も向上しな い。従来行われてきたガラス研磨後の脱アルカリ沿海 は、これだけでは廃食防止に不十分であった。このた め、脱アルカリ洗浄の後に、ガラス表面にアルコキシド 法によりシリコン酸化物をコートする方法も行われてき米 *たが、充分に反応させるためには、600℃以上の加熱 が必要であり、これは、強化処理濃度400~480℃ を大幅に越すため、シリコン酸化物のガラス化が不完全 となる問題がある。

[0008] 連落、ガラスの研輸加工は、アルカリ研磨 液でガラスの骨格であるSi-O給色を切断しながら新 勝するシミカル・よカニカル研輸加工法 (CMP)によ り研磨されるため、研輸加工法 (後の表面にはゲル層が 表表。このゲル線に付着機の配置を表すと同時と表面 を柔らかくして、耐食性能及びヘッド研修後を下さ せるという同種がある。アルカリを含まない結晶化ガラ スでも、強化が多スの場合と同様である。

[0007] 本専明は、上地化学無化ガラスや結晶化ガラスを被気配縁用基板又は電子部品実施再基板として期いるときに開極しなるガラス基板の瞬体の防止及び関連を関して、ガラス基板の表面を改賞し、その表面に付着される磁性順の配向性を向上させるための対面に対象を表現しませるための大力を表現しませる。

[8000]

「課題を解決するための手段」 従来、半導体の洗浄・液 晶ガラスの洗浄には、イオン水、ガス等人懸能水が用い られてきたが、その大部分は、酸化透元確位(以下、〇 RPという)がマイナスのアルカリ顔で、付着粒子を除 ますることが目的であった。磁気に熱用基値双は電子部 品突鈍用基板として必要な耐腐食性、硬度、結晶配向性 の改善の目的でテストが行われた報告はない。本発明書 らは、テストの結果、〇RPの軽色の違いと変配で質の 効果との間には、従来知られていた付着物許去作用以外 に、表1のような関係があることを見出した。 (表1) (表1)

表面改質の内容	有効なORPの極性
ごみ付着物の除去	有機物にはマイナス、金属にはブラスが有効
腐食防止	ブラス
硬度の向上	プラス
結晶配向性の向上	プラス

[0009]本界明は、上記率実に着目して、標準作業 工程としてORPマイナスで除去できるどの等を除去し た後、ORPプラスの作用を利用することにより、磁気 記録用器板収は電子部品架使用添板として優れた特性を 寄するガラス基度を得ることができることを認定した。 [0010] 正限機運を解決するため、本発明が始は、 所定の形状に加工されたガラス基板を、洗浄の形が出 所定の形状に加工されたガラス基板を、洗浄し重板と加 でORPがガラスの機能が、不可能を開発しますることによ り、ガラスの解格を修復し、表面観度を向上させて、耐 強性能を改善することを特徴としている。研館加工は いて所定の形状化加工されたガラス基板を、洗浄工程に おいて、酸化造工電位がブラスの機能水で所乗等間処理 すると、ガラス基板の表面よりアルカリ成分、とくにN aが除去され、これと同時は、機能水の酸化力によりゲ 小化した3 i 一〇結合が回復され、劣化した基礎表面の 軽度が修復される。 [0011] ORPは+300ないし+1200mV、 処理時間は1ないし10分間であることが重ましい。こ の処理により、ガラス基板の表面の硬度が向上して耐腐 敏性が向上し、付着膜の配向性が向上する。このQRP 及び処理時間の範囲では、改質が増進される。

[0012]請求項4の発明によるガラス基板の表面処 理方法は、所定の形状に加工されたガラス基板を、洗浄 工程において、(イ) ORPがマイナス又はプラスの機 能水を用いてガラス基板を洗浄し、前記ガラス基板に付 着する微粒子を除去する洗浄処理と、(ロ)ORPがプ ラスの機能水を用いて、ガラス基板の表面からアルカリ 成分を除去すると同時にガラスの骨格を修復する改質処 理と、(ハ) 純水を用いて洗浄し、乾燥する処理を行う ことを特徴としている。この方法は、研磨工程の後に、 微粒子除去を必要する場合に有効である。洗浄処理にお いて、有機物の微粒子が除去されるので、ガラス表面が 平滑になり、改質処理における硬化、付着膜の配向性が 一層向上する。前記洗浄処理はORPが-50ないし-300mVの機能水で行ない、前配改質処理はORPが +300ないし+600mVの機能水で1ないし2分間 行なうととが望ましい。

[0013] ORPがプラスの機能水は、酸素ガスをす ゾン溶解膜を選じて水中に溶解して作られたものを、O RPがマイナスの機能水は、水素ガスを水素が解膜を通 じて水中に溶解して作られたものを用いることができ る。酸素ガス及は水素ガスを導入した機能水は、電解イ オン水と間じ作用を行うが、電解イオン水よりも製造コ ストが安く、経済的、工業的である。

[0014] 機能水は、水の電気分解を利用して作られたものを用いることもできる。コストは酸素ガス又は水素ガス導入機能水よりも高いが、ORP、p Hが同じなら、作用ははぼ同じであるので、代用することができる。

[0015]

【発明の美地の形態】 未発明によるガラス基板の表面処理方法は、研密加工工程を経た後の洗浄工程において、 報路、次の(イ)の後染機理と(ロ)の改資処理とを含む。すなわち、まず、(イ)〇RPがマイナス又はプラスの機能水を用いてガラス基板を統令し、基板レ村着する亡み(微光子)を除去する。〇RPがマイナの機能水による洗浄により、ガラス表面に付着している有機物の廃粒子が除去される。〇RPがブラスの機能水による未少な機能がによる。

*洗浄により、主として金属系の微粒子が除去される。通 常、との洗浄の後、減水を用いて機能水を洗い流す。た だし、研磨工程において微粒子の付着が見られない場合 は、(イ)の工程は不要である。すなわち、ガラスは通 常、水中では色に帯電して微粒子を電気的に吸着してい るが、どみと基板を同電位にすれば、電気的に反発して ごみが剥がれ落ちる。有機物微粒子除去に用いられる機 能水のORPは、-300mV以上が有効範囲である。 これ未満であると、アルカリ度が強く、ガラス骨格の破 壊が過大になるからである。好適な範囲は、ガラス基板 の研磨条件、すなわち、研磨剤の種類や研磨時間(浸漬 時間) 等により異なる。図8は、研磨条件と表面粗さの 漁いを示す。同図は、pH6~4で浸漬時間1~3分間 の範囲が好適であること、pH3になると、表面が勢い 粗くなることを示す。次に、(ロ) ORPプラスの機能 水を用いて基板を処理して、ガラス表面よりアルカリ成 分、とくにNaを除去する。これと同時に、機能水の酸 化力によりゲル化したSi-O結合を回復させる。遠 常、との後、純水を用いて洗浄し、乾燥する。これによ り、研磨工程において劣化した基板の表面硬度が修復さ れる。換言すると、研磨工程による基板表面のゲル層に よる劣化が治癒される。このガラス表面の改質処理にお いて用いられる機能水のORPは、+300ないし+1 200mVが有効範囲である。好適な範囲は+300な いし+600mVである。1200mVを越えると、酸 性が強く、ガラス表面が荒れてくるからである。好適な 能囲は、ガラス基板の研磨条件、すなわち、研磨剤の種 類や研磨時間等により異なる。 関9は、研磨条件と表面 から100 nmにおける硬さの違いを示す。間関は、S i O2 で研磨する場合は、機能水がp H 5、1分間浸漬 が、また、Ceを用いる場合は、pH8、3分間浸渍が 好適であることを示す。機能水には、必要に応じて、塩 化アンモニウムなどの電解質を加えてpH調整、H*イ オン量の調整をして、Na量の除去効率を増し、その作 用効果を向上させることができることは、自明のことで

【0016】次に、本発明の実施例を説明する。 「実施例1]

(1) ガラス基板

本実施例で用いたガラス基板は、表2に示した成分を有 するイオン強化型強化ガラスである。

[表2] 用いたガラス基板:イオン強化型強化ガラス

SiO2 62.0 wt% Al2O3 3.0 B2O3 1.0 Na2O 9.0 K2O 9.0 MgO 3.0

ZnO 12.0 TiO2 0.6

一補 3-

A 8 2 O 3 Sb2 O3 0.2 0.2

(2)強化処理

上記イオン強化型強化ガラスを、次の条件の元で強化処 理した。

450°C 加熱運度・ 加熱時期: 6.5時間 強化深さ: 50 µm

(3)最終研磨工程 強化処理を経た上記ガラス基板を、pH10のコロイダ ルシリカを研磨材として用いて、最終研磨工程を行っ

* **①**機能水処理による表面組度の改良

最終研磨工程を経たガラス基板に対して、下記の表3に 示す各種条件の元で、機能水を用いた洗浄処理により付 着微粒子を除去し、純水で機能水を洗い流して、表面粗 度の改良を行った。機能水製造装置の電極室に加えた添 加剤は、ORP+側にはHci、ORP-側にはNH。 OHを用いた。但し、pH8、ORP-400mVの場 合は、何も加えない。空気中のCO: ガス等によりpH おになる.

(表3)

(4)機能水を用いた処理及び効果

ORP (mV)	pН	処理時間
- 370	9	1分
+ 400	6	"
+ 560	5	"
+ 680	4	"
0 £8 +	3	,,
+1140	2	. "

ж

この表面相摩の改良のための機能水処理の結果は、図1 に示すとおりである。表面粗度測定には、測定器「Ta risteri (商標)を用いた。上記ORPの範囲の いずれにおいても、処理なしの場合に比し、最大平均租 度が5~7オングストロームと、極めて優良な値を示し ている。

②機能水処理によるアルカリ成分の除去

上記機能水処理による表面粗度の改良に続き、ORP6 00mV、pH4,5の機能水を用いて、1分間浸漬処 理し、純水で洗浄した後、乾燥した。アルカリ成分の測 定には、表面分析器「ESCA」(アルバックファイ社 製) を用いた。図2にその測定結果を示す。図2には、 比較のため、機能水処理をしないガラス基板の測定値も 併せて示してある。 図2から明らかなように、処理後の Na. Kの表面場度が下がっている。

②機能水処理による表面硬度の改善

上記機能水処理によるアルカリ成分除去と同時に、上記 機能水を用い、同時間浸渍処理して、表面硬度の改善を 行った。図3は、機能水処理の有無と基板の表面からの 深さと硬度比との関係を示す。硬度比は、押込み法によ り測定した。図3は、ガラス基板(ジンクシリケート) に機能水処理を行った場合の硬度を、同ガラス基板に機 能水処理を行なわない場合の硬度及びNi~Pアルミ合 金基板の硬度と対比的に示している。図3から分かるよ うに、機能水処理により、研磨工程において生じた硬度 の劣化が修復されている。表面から1 4 m以上内部で は、ほぼパルク硬度となっており、本実験の場合は、研 磨工程によりガラスのゲル層が 1 μm程度であることを 示している。HDDにおけるトラック幅、浮上量の減少 に伴い 雄体の表面暗度が一層重要になってきている。 GMRヘッドに要求される衝撃強度に耐えるには、最表 面強度が重要である。との観点からも、機能水処理が有 効であるととが組る。

の機能水処理による磁性膜の配向性の向上

上記②及び③の処理を経たガラス基板に対して、ORP 500mV、pH5の機能水を用いて、1分間浸渍処理 した。との処理により、強化処理及び研磨によりゲル化 したガラスの骨格Si-Oの結合状態が、水の酸化力に より回復し、安定なSiO。に近付くため、付着膜の配 向性を示す $\Delta \theta$ 5 0 が小さくなり、結晶が揃う。すなわ ち、ガラスの骨格は、SiO。がゲル化すると、結合エ ネルギーが大きくなり、SiO。が結晶化すると、結合 エネルギーが小さくなって、安定なSiO、となる。図 4は、機能水処理によるガラス (ジンクシリケートガラ ス) の結合エネルギーの変化と $\Delta \theta = 0$ との関係を示す グラフである。図4(a)(b)(c)のそれぞれの縦 軸は光電子カウント数、横軸は結合エネルギーである。 間図(a)は強化処理なし、機能水処理なしの基板の例 を示し、K-Naイオン交換処理がないため、結合エネ ルギーの波が乱れない。(b)は強化処理あり、機能水 処理なしの例、(c)は強化処理ありで機能水処理をし た場合の例である。(b)は(a)よりも高エネルギー 側に、(c)は(b)よりも低エネルギー側にシフトし ていることが、認められる。すなわち、強化処理により 乱されたSi-O骨格が機能水処理により修復され、磁 性膜の配向性Δ θ 5 0 が小さくなり、結晶配向が明らか に向上される。

6)耐腐食性

通常の酸処理による基板 (比較例1) と本発明の処理方 法によるガラス基板との放置路食テストの結果を、図5 及び図6の図面代用AFM (原子間力顕微鏡) 写真で示 す。図5から、通常処理では、製造後1ケ月で腐食が見 **られたが、本発明方法によるものは、図8に示すよう** に、8ヶ月後も腐食は見られなかった。なお、図5、6 のスケールはX(高さ)がそれぞれ20 um, 5 umで ある。図6では拡大しても腐食が見当たらないことを意 味している。

の水分放出量の測定

本発明方法により、ORPが+450mVの機能水を用 いて1分間処理したガラス基板と、従来の通常酸処理に よるガラス基板 (比較例2) とについて、真空中加熱 (真空度10-"Torr内で、温度上昇10℃/1分の 割合で赤外線加熱) による水分放出量を測定した。測定 結果を、図7に示す。なお、比較例2では、59.6℃ より59.9℃までの発生水量で、H, O分子量が1. 88×1010個/cm1 であったのに対し、本発明方法 によるものは、58.9°Cより601.2°Cまでの発生 水量で、H, O分子量が1. 21×10**であった。こ のように、本発明方法によるものの方が水分放出量が少 なかった。その理由は、脱アルカリ処理の結果は、いず れの基板も同じであると思われるが、本発明方法による ものは、ゲル化を修正する酸化力により、ガラス骨格が 補修されて、水分吸着力が低いからであると思われる。*

* [0017]

[発明の効果]上述のように、請求項1の本発明方法に よれば、研磨工程を経たガラス基板を、洗浄工程におい てORPがプラスの機能水で所要時間処理するので、研 磨工程で劣化されたガラスの骨格が修復されるととも に、ガラス基板の表面の硬度が向上し、その表面に付着 される膜の配向性が向上し、耐食性能が改善される。従 って、磁気記録用基板又は電子部品実験用基板として必 要なガラス基板の腐食の防止及び耐衝撃強度の向上とい う最終的目的が達成され、磁気記録媒体や電子部品の品 智向 上が可能である。

【0018】請求項4の発明によれば、機能水による洗 浄処理により、ガラス基板表面の微粒子が除去されてガ ラス基板の表面の平滑性が向上するので、その後の機能 水による改賞処理により硬化がさらに進行し、耐腐食 性、耐衝撃強度及び付着膜の配向性が一層向上する。 【0019】請求項6の発明によれば、電解イオン水よ りも安価で工業性に優れた媒質を用いて、基板表面の改 質を行うことができる。 「図面の簡単な説明】

[図 I] ガラス基板を機能水で処理した場合の表面程度 の変化を示すグラフ。

「図2」機能水処理の有無と表面硬度と表面からの深さ の関係を示すグラフ。

「図3] 各種基板の最表面の硬度比を示すグラフ。

【図4】機能水処理の有無とガラスの結合エネルギー変 化と $\Delta \theta$ 50との関係を示すグラフ。

「関5]機能水処理をしないガラス基板(比較例1)の 腐食テストの結果を示すグラフ。

[図6]本願発明方法を適用された基板の腐食テストの 結果を示すグラフ.

[図7] 完成基板からの水分放出量テストの結果を示す グラフ.

【図8】研磨条件の違いと表面処理による表面組さの達 いを示すグラフ。

【図9】研磨条件の違いと表面から100nmにおける 硬さの違いを示すグラフ、

```
【手続補正書】
```

[提出日] 平成13年3月27日(2001.3.2 7)

【手続補正1】

[補正対象書類名] 明細書

【補正対象項目名】0016 [補正方法] 変更

[補正内容]

※「0016]次に、本発明の実施例を説明する。

[事旅例1]

(1) ガラス基板

本実施例で用いたガラス基板は、表2に示した成分を有 するイオン強化型強化ガラスである。

[表2] 用いたガラス基板:イオン強化型強化ガラス

ガラス基板の成分: SiO2

A 12 O3

62.0 wt% 3.0 1.0

B2 O3

- 補 5-

Na2O	9. 0
K2 O	9. 0
MgO	3.0
ZnO	12.0
T i O2	O. B
A s 2 O 3	0.2
S h 2 O 3	0 2

(2)強化処理

上記イオン強化型強化ガラスを、次の条件の元で強化処理した。

加熱湿度: 450℃ 加熱時間: 6.5時間 強化深さ: 50μm (3)最終研節工程

強化処理を経た上記ガラス基板を、pH10のコロイダルシリカを研磨材として用いて、最終研磨工程を行っ

ルンリガを射線材として用いて、最終射器上程を行った。

* ①機能水処理による表面料度の改良

最終研算工程を経たガラス基板に対して、下転の表3 に 示する事業件の元で、機能水を用いた溶溶処理により、表前相 着機計を停む、 純水で機能水を用いた溶溶処理により、表前相 着機計をであった。 機能水準塗緩圏の電磁室に加えた添 加削は、 ORP + ME に付 は ORP - ME によい の Hを用いた。 個と 、 p H B 、 ORP - 4 0 の N O M 合は、 何も加えない。 空気中の C O、 ガス等により p H 8 となる。

8になる。 【表3】

	几項目 スケア 関連し

14年及び効果 *			
ORP (mV)	рН	処理時間	
- 370	9	1 53	
+ 400	6	"	
+ 560	5	"	
+ 680	4	,,	
088 +	3	"	
+1140	2	"	
1		í	

この数面程度の定負のための機能が必要の結果は、図1 に示すさおりである。表面相違皮測定には、測定器「Ta ristep」(衡視)を用いた。上部ORPの範囲の いずかにおいても、処理なしの場合に比し、最大平均組 変が5~7オングストロームと、極めて便良な値を示し ている。

②機能水処理によるアルカリ成分の除去

③機能水処理による表面硬度の改善

上記機能水処理によるアルカリ成分除去と同時に、上記 機能水を用い、同時間浸漬処理して、表面硬度の改善を 行った。図3は、機能水処理の有無と基板の表面からの 郷さと眼壁比との瞬気を示す。硬度比は、押込み投化より 別能に北、図3は、ガラス基板(ジンクシリケー) に機能水処理を行った場合の硬度が、同ガラス基板に機 能水処理を行った場合の硬度がいる。図3から分かえ うた、機能水処理なより、研粛工程において生じた硬度 の劣化が修復されている。近面から1 μm以上内部で は、ほぼパルク型度となっており、本実験の場合は、研 底工器によりガラスのグル情が1 μm 程度であることを 示している。HDDにおけるトラック幅、浮上面の減少 に作りがラスのグル情が1 μm 程度であることを 示している。HDDにおけるトラック幅、浮上面の減少 に停止、媒体の表面強度が一層重要になってきている。 GMRペッドに要求される衝撃態度に耐えるには、最表 面強度が重要である。この概点からも、機能水処理が有 効であることが判る。

の機能水処理による磁性膜の配向性の向上

上記**②及び②の処理を経**たガラス基板に対して、ORP 500mV、pH5の機能水を用いて、1分間浸渍処理

した。との処理により、強化処理及び研算によりゲル化 したガラスの骨格Si-Oの結合状態が、水の酸化力に より回復し、安定なSiO、に近付くため、付着膜の配 向性を示す△650が小さくなり、結晶が描う。すなわ ち、ガラスの骨格は、SiO,がゲル化すると、結合エ ネルギーが大きくなり、SiO、が結晶化すると、結合 エネルギーが小さくなって、安定なSiO、となる。図 4は、機能水処運によるガラス (ジンクシリケートガラ ス)の結合エネルギーの変化と $\Delta \theta$ 50との関係を示す グラフである。図4(a)(b)(c)のそれぞれの鮮 軸は光電子カウント数、横軸は結合エネルギーである。 同図(a)は強化処理なし、機能水処理なしの基板の例 を示し、K-Naイオン交換処理がないため、結合エネ ルギーの波が乱れない。(b) は強化処理あり、機能水 処理なしの例、(c)は強化処理ありで機能水処理をし た場合の例である。 (b) は (a) よりも高エネルギー 側に、(c)は(b)よりも低エネルギー側にシフトし ていることが、認められる。すなわち、強化処理により 乱されたSi-O骨格が機能水処理により修復され、磁 性臓の下地膜として使用されるTi膜の配向性Δθ50 が小さくなり、結晶配向が明らかに向上される。この結 果、磁性膜も配向し、SNが下がる。これは修復された 表面とTi膜が、ゲル層がなくなるので、原子レベルで 強固に結合するためである。

5)耐腐食性

通常の酸処理による基板(比較例1)と本発明の処理方

法化よるガラス基製との放電販舎テストの結果を、図5 及び図6の図面代用AFM(原子間力車等線)写真で示 す。図5から、通常処理では、製造後1ヶ月で資金が見 られたが、本発別方法によるものは、図6に示すよう に、8ヶ月後も腐食は見られなかった。なお、図5・6 のスケール又は前定無域、戸場は高さである。図6では 拡大しても腐食が見当たらないことを意味している。 電か分泌出版の側近

本発明方法により、ORPが+450mVの機能水を用 いて1分間処理したガラス基板と、従来の通常験処理に よるガラス基板 (比較例2) とについて、真空中加熱 (真空度10⁻³Torr内で、温度上昇10℃/1分の 割合で赤外線加熱) による水分放出量を測定した。測定 結果を、図7に示す。なお、比較例2では、59.6℃ より59.9°Cまでの発生水量で、H, O分子量が1. 86×1010個/cm2 であったのに対し、本発明方法 によるものは、58、9℃より601、2℃までの発生 水量で、H, O分子量が1, 21×101°であった。と のように、本発明方法によるものの方が水分的出量が少 なかった。その理由は、脱アルカリ処理の結果は、いず れの基板も同じであると思われるが、本発明方法による ものは、ゲル化を修正する酸化力により、ガラス骨格が 補修されて、ガラス内部よりのアルカリ金属の移動が抑 制されるので、水分吸着力が低いからであると思われ **5.**